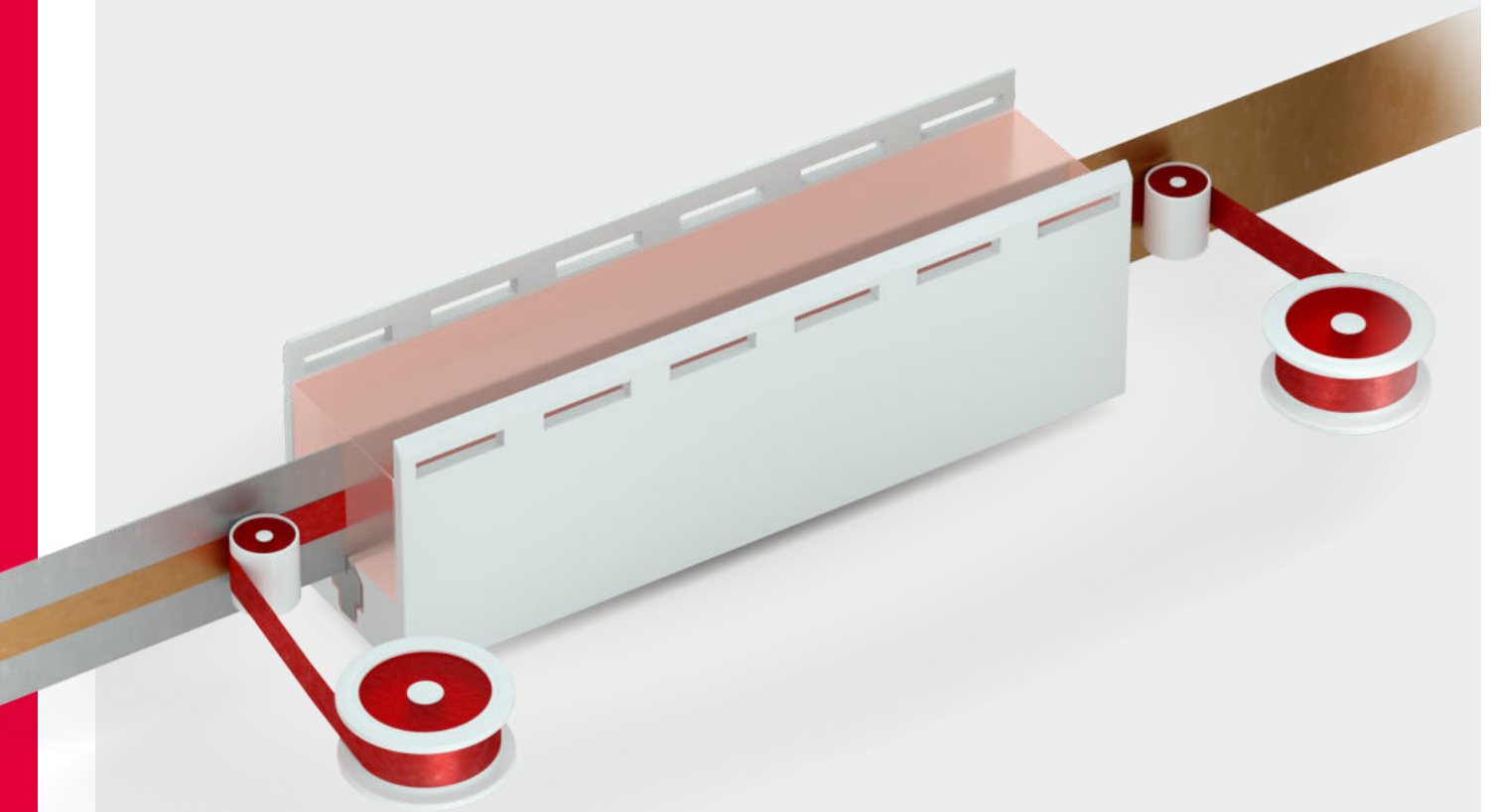


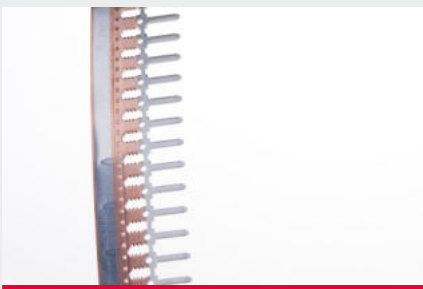
## BANDGALVANIK

# KLEBETECHNIK

Die Klebetechnik ist eine besondere Kombination der Streifen- und Tauchtechnik. Mit ihrem Einsatz erzielt man auf Bändern Streifen unbeschichteter Zonen. Hierbei werden Endlosklebebänder mit definierter Breite vor der Beschichtung auf die Vorder- und/oder Rückseite des Bandes aufgebracht. Mehrstreifen-Ablebungen sind bei diesem Verfahren möglich



Im Bereich der Klebebandkanten müssen die Bänder vollflächig ungestanzt sein. Die Galvanisierung erfolgt dann im Tauchverfahren. Am Ende des Prozesses werden die aufbrachten Klebebänder wieder rückstandsfrei entfernt.



## KLEBTECHNIK ANWENDUNGSBEREICHE

Speziell bei einer Verzinnung von Bändern empfehlen wir häufig die Klebtechnik, da Zinn den mechanischen Stress anderer Verfahren nicht besonders gut standhält. Häufig wird dieses Verfahren auch für walzplattierte AlSi-Einlagen verwendet, um diese vor dem chemischen Angriff der Elektrolyte (Spritzer o.ä.) zu schützen.

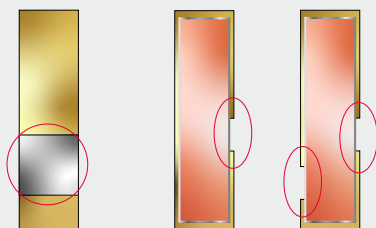
## KLEBTECHNIK TECHNISCHE DATEN

<b>Beschichtungen</b>	> Alle Metalle: Kupfer, Nickel, Zinn, Gold, Silber
<b>Bandabmessungen/ Dimensionen</b>	> Bandbreite max. 150 mm / Banddicke max. 1,5 mm > Auslaufzonen 0,5 - 1 mm

## KLEBTECHNIK EINSPARPOTENTIALE

Bei der Klebtechnik fallen keine artikelspezifischen Werkzeugkosten an. Da eine einseitige streifenförmige Beschichtung möglich ist, lassen sich im Vergleich zum Tauchverfahren mehr als 50% an Edelmetall einsparen. Das Verfahren stellt sich in zwei Ausprägungen dar: Den nicht zu beschichteten Teilbereich des Produkts zu maskieren (links) oder umgekehrt den zu beschichtenden Teilbereich heraus zu stellen (rechts).

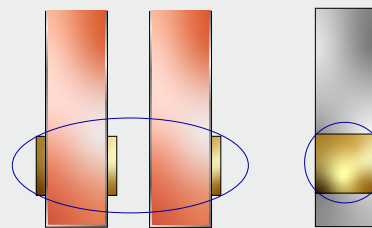
### KONVENTIONELLE KLEBTECHNIK



Frontalansicht

Seitenansicht

### IMO KLEBTECHNIK



Seitenansicht

Frontalansicht



MEHR ZUR BANDGALVANIK

